

無電解銅めっき触媒用銅ペースト
Copper paste for electroless copper plating catalyst

OPCコパシードSCP

OPC COPASEED SCP

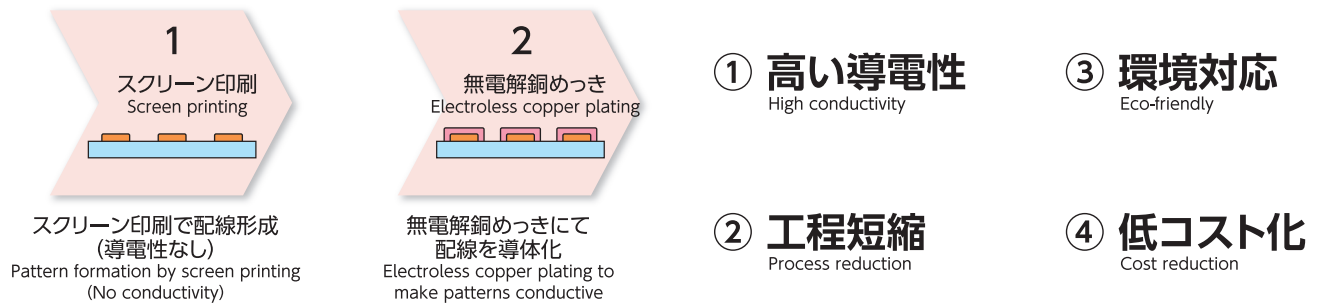
- 無電解銅めっきを併用して高い導電性
High conductivity by combination with electroless copper plating
- 低温での硬化が可能でフィルムに対応
Low temperature curing is possible and good compatibility with films
- 無電解銅めっきの優れた析出性
Excellent depositability of electroless copper plating
- 良好な密着性
Excellent adhesion

OPCコパシードSCP + 無電解銅めっき

OPC COPASEED SCP + Electroless copper plating

OPCコパシードSCPを用いた配線形成方法

Pattern formation method using OPC COPASEED SCP



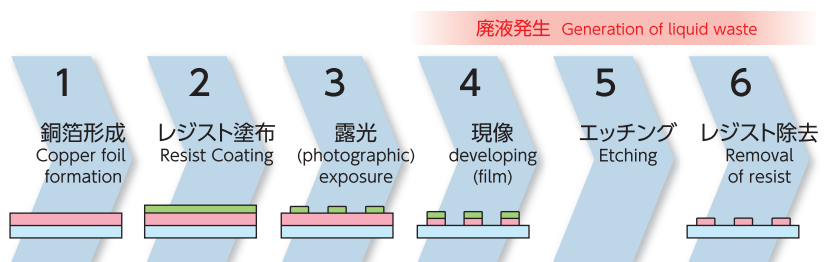
導電性ペーストのみの配線形成時の課題

Issues when pattern is formed using only conductive paste

- 酸化による導電性の低下
Decrease in conductivity by oxidation
- マイグレーションの発生
Migration occurrence
- 抵抗値の確保で厚膜化
Thick film by securing resistance value
- 価格の変動・高騰
Price fluctuations and price hikes

一般的なプリント基板の配線形成方法

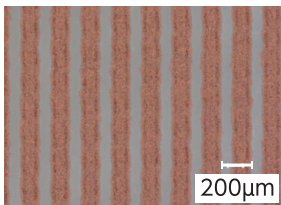
General PCB wiring formation method



低温で硬化が可能な銅ペースト

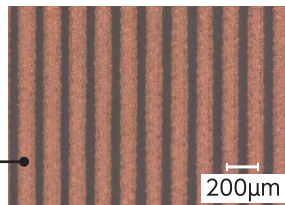
Copper paste curable at low temperatures

配線形成例(スクリーン印刷)
Pattern example(Screen printing)

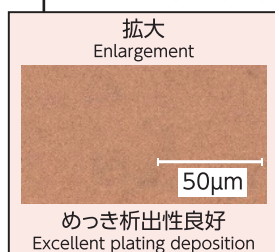


120°C1時間で硬化
Curing at 120°C for 1 h

無電解銅めっき後
After electroless copper plating



配線上へ選択的にめっきが析出
Selective plating on pattern



低温硬化のため
フィルムに対応可能

Compatible with films due to low temperature curing

良好な密着性

Excellent adhesion

ピール強度
Peel strength

